



特性

- 》优异的热传导率
- 》良好的柔软性和填充性
- 》带自粘而无需额外表面粘合剂
- 》良好的绝缘性能

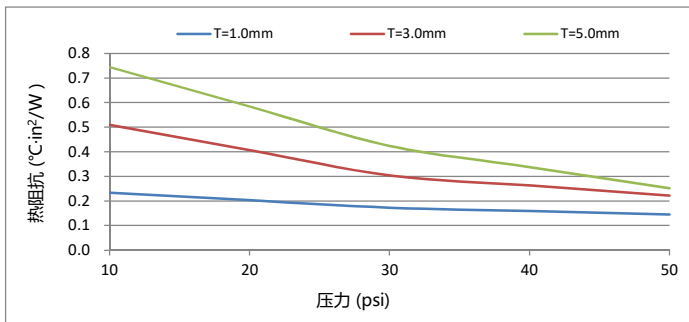
应用

- 》AI服务器
- 》半导体封装
- 》低空飞行器
- 》光通信产品
- 》5G基站

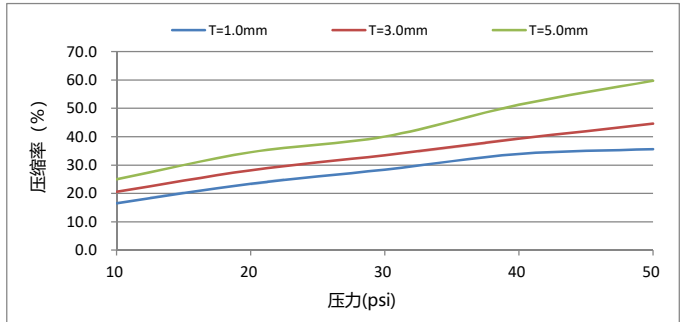
TIF[®]700HU 一款在满足顶级散热需求同时兼顾优异组装工艺性的高端可压缩型导热垫片。它通过创新的材料配方，成功实现了超高导热率与适中硬度的理想结合。这种独特的性能配比，使其既能高效应对超高热流密度带来的散热挑战，又具备了良好的机械强度和可压缩性，便于生产加工与安装，为高功率密度电子设备提供了兼具卓越散热效能与高可靠性的界面材料解决方案。

TIF [®] 700HU 系列特性表			
产品特性	典型值		测试方法
颜色	灰色		目视
结构&成份	陶瓷填充硅橡胶		-
厚度范围 (inch/mm)	0.020~0.030 0.50~0.75	0.040~0.200 1.00~5.00	ASTM D374
硬度 (Shore OO)	60	50	ASTM D2240
密度 (g/cm ³)	3.4		ASTM D792
建议使用温度范围 (°C)	-40 ~ 200		-
击穿电压 (V/mm)	≥5000		ASTM D149
介电常数 @1MHz	9.0		ASTM D150
体积电阻率 (Ohm-cm)	> 1.0×10 ¹²		ASTM D257
导热系数 (W/m-K)	10.0		ASTM D5470
	10.0		ISO22007
阻燃等级	V-0		UL94 (E331100)

热阻抗



压缩率



产品规格

标准厚度: 0.020" (0.50 mm) ~0.200" (5.00 mm)，以 0.010" (0.25 mm) 为增量。
标准尺寸: 16"×16" (406 mm×406 mm) 。

TIF[®]系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度或想了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系。

全球方案: 在地服务

中国: +86-769-38801208
 台湾: +886-2-2277-1007
 加拿大: +001-604-2998559
 越南: +84-396852859

service@ziitek.com

www.ziitek.com

产品型号说明

TIF7 00 HU

- 导热系数: 10.0 W/m-K & 硬度: 50
- 厚度: 20 mils~ 200 mils
- 产品系列

